

电子行业周报 (9.02-9.08)

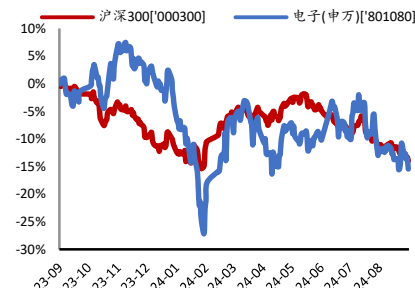
关注9月10日华为&苹果发布会

强于大市(维持评级)

投资要点:

- **苹果与华为同日发布新品，竞相展现创新实力。**9月10日将迎来一场科技盛宴，苹果将于10日凌晨1点举行秋季发布会，届时将带来iPhone 16系列（包含16、16 Plus、16 Pro以及16 Pro Max四款机型）新品以及新一代 AirPods和Apple Watch；华为将于10日14:30正式召开非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会，届时从三折叠屏手机到nova13系列新机，再到全新的智能SUV问界M9五座版均有望亮相。
- ✓ **iPhone 16系列作为苹果AI功能预热机型，端侧AI再下一城。**iPhone 16系列将标配新的A18系列芯片，升级8GB内存，同时将配置全新人工智能系统“Apple Intelligence”。一方面，新机有望通过这一系统改进其语音助手“Siri”，从相机相册、日历备忘录到浏览器，几乎苹果系统中所有原生应用都将被AI赋能；另一方面，Apple Intelligence将应用于iOS 18，预计将实现多个内置应用的AI更新，包括备忘录、邮件、照片、Music和健身等。据悉，苹果已告知供应商为大约8800万~9000万部智能手机备货零部件，这比去年8000万部新iPhone的初始零部件订单有所增长。同时，iPhone 16系列的面板已于今年7月开始出货，出货量相较2023年6月和7月的iPhone 15系列高出20%。在人工智能的浪潮中，苹果通过本次战略举措，强化其在人工智能领域的竞争力，并引领消费智能终端的发展潮流。而苹果系统与生态的加强也将加速消费电子换机潮的节奏，同时AI功能将带来智能硬件中的处理器、存储、电池、快充、散热等部件的升级，为产业链内其他关键企业带来全新机遇。
- ✓ **华为首款三折叠手机即将问世，引领新一轮硬件创新。**华为预计于发布会上公布其首款三折叠手机Mate XT非凡大师，据悉，Mate XT预计将搭载华为自家的麒麟9系列处理器，采用了“内折+外折+双铰链”的设计，实现稳定的三次折叠，三折叠的折叠手机或将成为折叠手机形态的全新趋势。而从华为于2024年3月29日公布的“折叠屏设备”专利内容可以看出，三折手机屏幕比例有望从1:1扩展为16:9，也意味着屏幕、盖板、中框等相关材料的面积将同步增长。据第一财经援引IDC 2024年第二季度折叠屏手机市场数据显示，24Q2中国折叠屏市场保持了105%的高速增长，总出货量来到了257万台。华为表现极为强势，已经取得41.7%的市场份额。而三折手机有望开启折叠屏手机形态演进的全新浪潮，引领新一轮硬件创新，打开全新成长空间。进一步地，三折叠设备将提升多数应用场景在折叠机上的适配性，进而转换更多的传统手机用户及Pad用户，进一步打开折叠机市场的天花板，而深耕折叠机材料和零部件的相关企业，有望在三折设备的发展中充分受益。
- **投资建议：**建议关注消费电子产业链相关公司，如立讯精密、恒铭达、领益智造、东山精密、鹏鼎控股、德赛电池、珠海冠宇、蓝思科技、歌尔股份、赛腾股份、凯盛科技、科森科技、弘信电子、兴森科技、长信科技、卓胜微、唯捷创芯等。AI应用终端方向，建议关注华勤技术、福蓉科技、胜宏科技、飞荣达、聚飞光电、兆驰股份、瑞丰光电、瑞芯微、龙芯中科、伟时电子、春秋电子、宇环数控、英力股份、珠海冠宇、思泉新材、闻泰科技、全志科技、水晶光电、领益智造、汇创达等。折叠屏方向，建议关注凯盛科技、瑞华泰、长信科技、宝钛股份、福蓉科技、东睦股份、精研科技、金太阳、宇环数控、铂力特、华曙高科等。
- **风险提示：**技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险；行业景气不及预期。

一年内行业相对大盘走势



电子行业估值 (PE)



团队成员

分析师 杨钟
执业证书编号: S0210522110003
邮箱: yz3979@hfzq.com.cn

联系人 詹小瑁
邮箱: zxm30169@hfzq.com.cn

相关报告

- 《关注9月10日苹果秋季发布会》——2024.09.01
- 《关注〈黑神话:悟空〉对AI PC及高清显示行业的带动》——2024.08.25
- 《关注折叠屏手机形态演进及新机发布》——2024.08.18

正文目录

一、	本周市场表现.....	3
1.1	电子板块本周表现.....	3
1.2	SW 电子个股本周表现	3
1.3	电子板块估值分析.....	4
二、	行业动态跟踪.....	6
2.1	半导体板块.....	6
2.2	AI 板块.....	6
2.3	消费电子板块.....	11
2.4	汽车电子板块.....	11
2.5	面板板块.....	15
三、	公司动态跟踪.....	17
四、	风险提示.....	19

图表目录

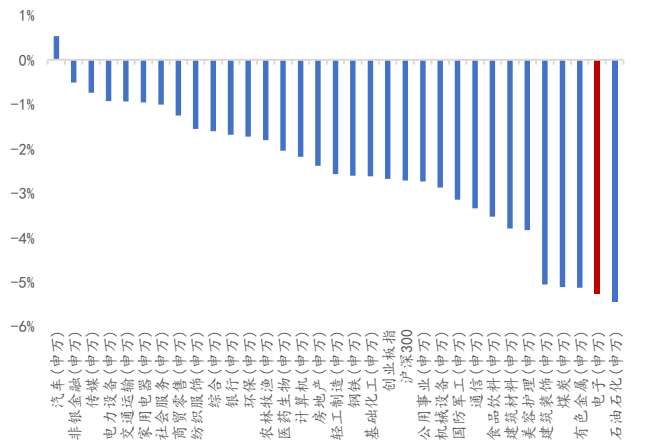
图表 1:	SW 各行业板块本周市场表现.....	3
图表 2:	电子板块成交额及日涨跌幅.....	3
图表 3:	电子细分领域本周涨跌幅 (%)	3
图表 4:	SW 电子本周涨幅前十个股 (%)	4
图表 5:	SW 电子本周跌幅前十个股 (%)	4
图表 6:	SW 电子本周换手率前二十个股 (%)	4
图表 7:	SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM)	5
图表 8:	SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM)	5
图表 9:	过去一周股东增减持更新	18
图表 10:	过去一周股权激励一览.....	19

一、 本周市场表现

1.1 电子板块本周表现

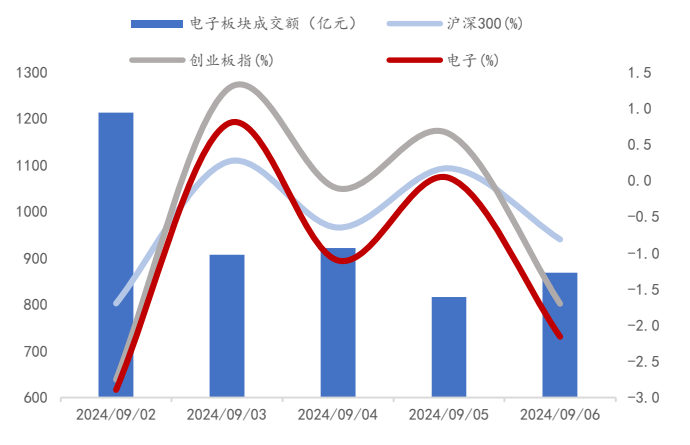
大盘表现上，本周（0902-0908）创业板指数下跌 2.68%，沪深 300 指数下降 2.71%。本周电子行业指数下跌 5.27%。行业表现上，电子行业涨跌幅位列全行业的第 30 位，本周汽车、非银金融、传媒板块涨跌幅位居前列。

图表 1：SW 各行业板块本周市场表现



数据来源：Wind，华福证券研究所

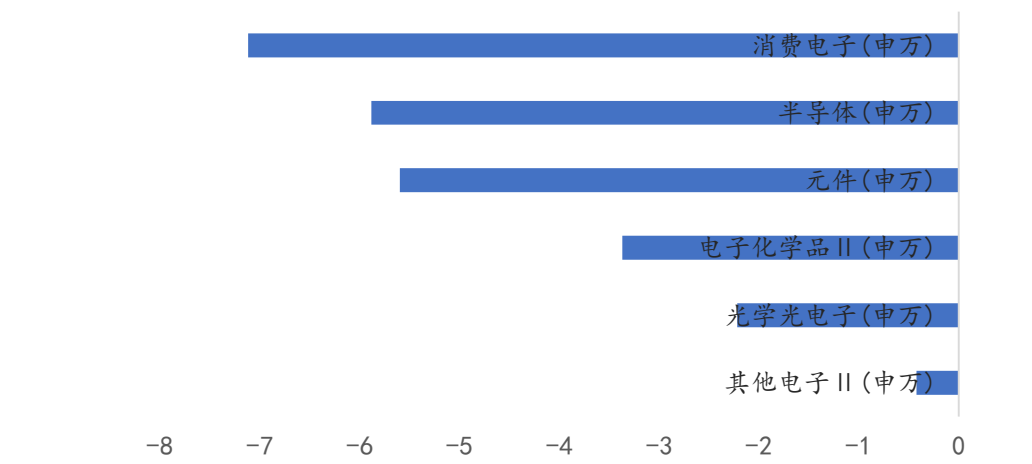
图表 2：电子板块成交额及日涨跌幅



数据来源：Wind，华福证券研究所

从电子细分行业指数看，本周电子细分板块涨跌幅均呈下降态势，具体来看，其他电子板块跌幅最小，周涨跌幅为-0.42%；消费电子块跌幅最大，周涨跌幅为-7.12%。

图表 3：电子细分领域本周涨跌幅（%）

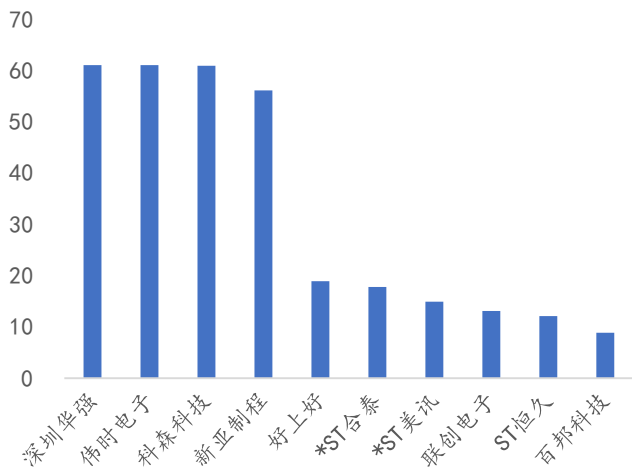


数据来源：Wind，华福证券研究所

1.2 SW 电子个股本周表现

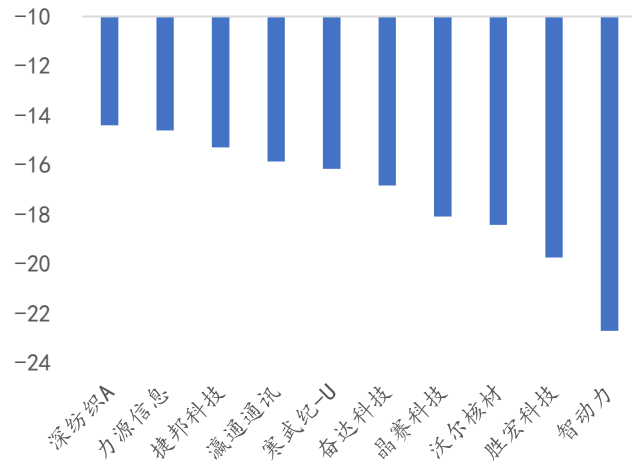
从个股维度来看，SW 电子板块中，深圳华强（61.05%）、伟时电子（61.05%）等位列涨幅前列；智动力（-22.71%）、胜宏科技（-19.75%）等位列跌幅前列。

图表 4: SW 电子本周涨幅前十个股 (%)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

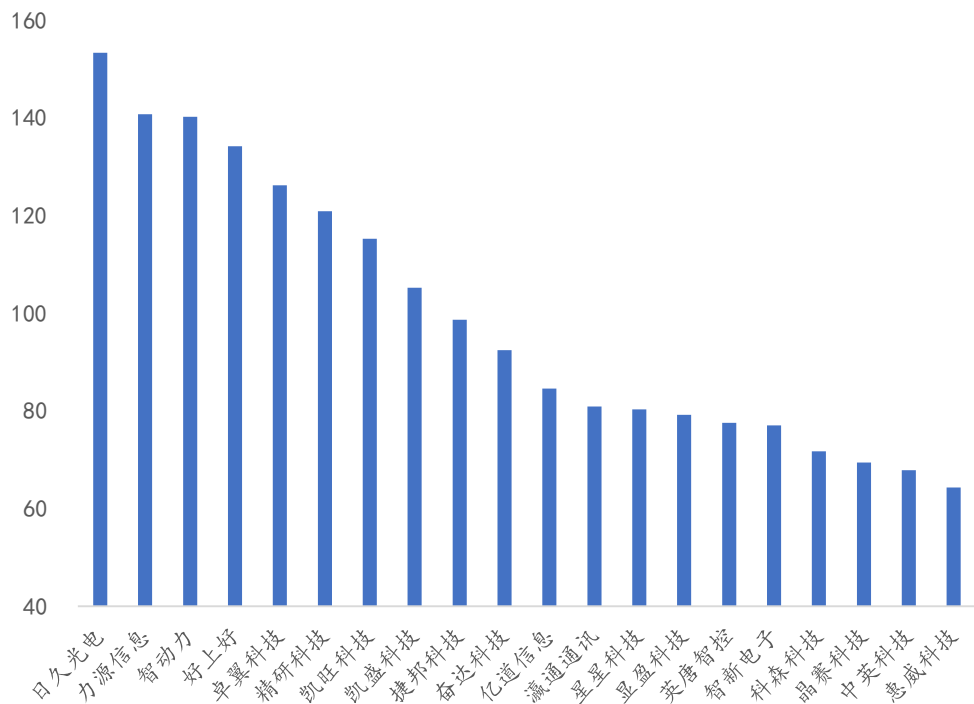
图表 5: SW 电子本周跌幅前十个股 (%)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

从换手率来看,本周电子行业个股换手率最高的是日久光电,换手率为153.31%。其余换手率较高的还有力源信息(140.73%)、智动力(140.19%)、好上好(134.17%)。

图表 6: SW 电子本周换手率前二十个股 (%)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

1.3 电子板块估值分析

从本周 PE 走势来看,整体电子行业估值低于近一年、五年平均值水平,但高于近三年平均值水平。本周 PE (TTM) 为 39.5 倍,较上周有所下调。

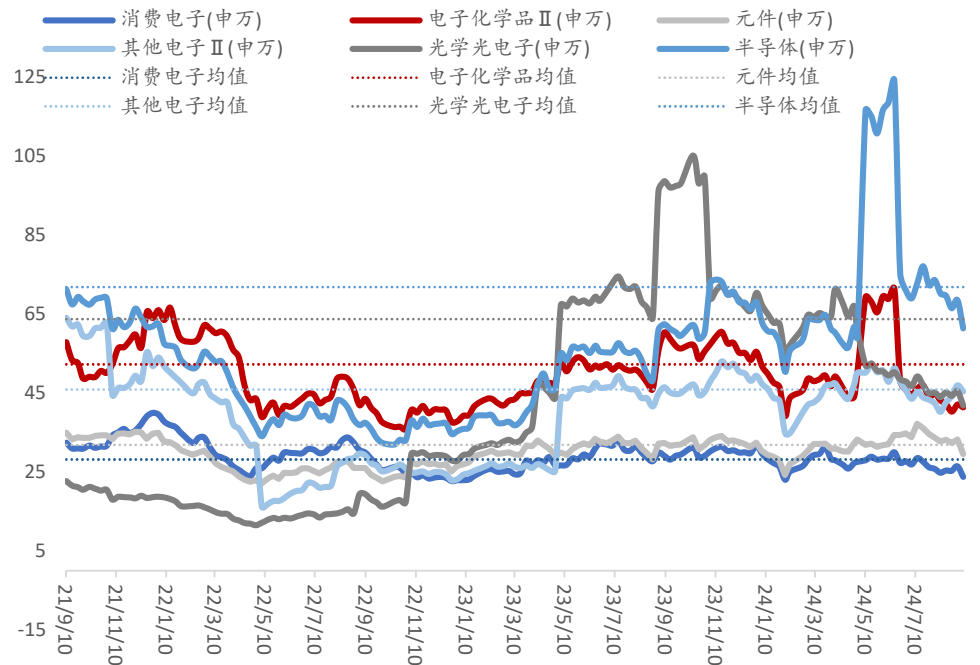
图表 7: SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

细分领域上, 本周消费电子、电子化学品、元件、其他电子、光学光电子和半导体板块 PE 分别为 23.73、41.36、29.43、45.37、41.84 和 61.36, 本周电子细分板块估值均有一定程度回落。

图表 8: SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

二、行业动态跟踪

2.1 半导体板块

1) 台积电明年资本支出冲新高 2 纳米需求超预期

美国半导体行业协会(SIA)9月3日宣布,2024年7月全球半导体行业销售额达到513亿美元,较2023年7月的432亿美元增长18.7%,比2024年6月的500亿美元增长2.7%。

半导体的月度销售额由世界半导体贸易统计组织(WSTS)编制,代表三个月的移动平均值。按收入计算,SIA代表了美国半导体行业的99%,占非美国芯片公司的近三分之二。

SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 表示:“7月份全球半导体市场继续同比大幅增长,月销售额连续第四个月环比增长。美洲市场7月份增长尤为强劲,销售额同比增长40.1%。”

从地区来看,美洲(40.1%)、中国(19.5%)和除中国、日本外亚太其他地区(16.7%)的销售额同比上涨,但日本(-0.8%)和欧洲(-12.0%)的销售额下降。5月份美洲(4.3%)、除中国、日本外亚太其他地区(3.9%)、日本(3.3%)和中国(0.9%)的销售额环比上涨,但欧洲(-0.5%)的销售额下降。(资料来源:集微网)

2) SEMI: AI 芯片、存储驱动,今年全球半导体营收估增 20%

国际半导体产业协会(SEMI)预估,今年全球半导体营收可望增长20%,人工智能(AI)芯片及存储是主要增长动能。明年随着通讯、工业及车用等需求健康复苏,半导体营收将再增长20%。

SEMI 今天下午举办国际半导体展 SEMICON TAIWAN 2024 展前记者会,SEMI 产业研究资深总监曾瑞榆解析全球半导体市场发展趋势。

曾瑞榆指出,今年上半年电子设备销售约较去年同期持平,第3季可望年增4%,全年将增加3%至5%,略低于原预估的5%至7%水准。今年上半年半导体营收较去年同期增长逾20%,曾瑞榆预期,今年半导体营收可望增长20%,除存储价量齐扬,AI芯片也是主要增长动能。曾瑞榆说,不计存储的半导体营收今年将增长约10%,若再排除AI相关芯片产品,今年半导体营收将仅增长3%。

曾瑞榆表示,随着通讯、工业及车用等供应链库存逼近谷底,明年需求可望健康复苏,明年半导体营收有机会增长20%水准。他指出,晶圆厂的产能利用率于今年第1季落底,第2季开始逐步复苏,预期第3季产能利用率可望达70%,第4季再进一步复苏。

曾瑞榆表示,今年上半年中国的投资金额较去年同期激增90%,并不符合市场需求,主要是担心美国采取更严苛管制,积极建构足够的成熟制程产能;其余国家上半

年投资大多较去年同期减少。

曾瑞榆预估，在中国大陆基于地缘政治因素大举投资下，今年全球半导体设备市场可望较去年微幅增长 3%，至 1095 亿美元，明年在先进逻辑芯片及封测领域驱动下，设备市场将较今年增长 16%，至 1275 亿美元规模。

他表示，美国 2023 年至 2027 年半导体设备支出年复合增长率可望达 22%，欧洲及中东地区年复合增长率达 19%，日本 18%、韩国 13%，中国台湾约 9%，中国大陆恐呈现负增长。至于硅晶圆市况，曾瑞榆预期，今年下半年硅晶圆出量可望逐季增长，不过，今年总出货量恐将减少 3%，明年可望复苏。（资料来源：集微网）

3) SEMI：上半年中国大陆芯片设备支出约 1779 亿元，超过了台、韩、美总和

国际半导体产业协会（SEMI）近日表示，今年上半年中国大陆在芯片制造设备上的支出达到 250 亿美元（当前约合 1779.40 亿元人民币），这超过了韩国、中国台湾和美国的总和。

SEMI 数据显示，中国大陆在 7 月份保持了强劲的支出，并有望再创全年纪录。预计中国大陆还将成为建设新芯片工厂的最大投资者，其中包括购买设备，预计芯片设备全年总支出将达到 500 亿美元。

由于半导体生产的本土化趋势，SEMI 预计到 2027 年，东南亚、美国、欧洲和日本的年度支出将大幅增长。

SEMI 市场情报高级总监 Clark Tseng 表示，“至少有 10 多家二线芯片制造商也在积极购买新工具，这共同推动了中国大陆的整体支出。”

中国大陆是全球顶级芯片设备供应商最大的营收来源，美国应用材料公司、泛林集团和科磊最新公布的季度财报显示，中国大陆市场贡献了各公司 44% 的营收。公司披露的信息显示，日本 TEL（Tokyo Electron）和荷兰 ASML 来说，中国大陆市场更大，TEL6 月份当季 49.9% 的收入来自中国大陆，而荷兰 ASML 49% 的收入来自中国。

在全球经济放缓的背景下，中国大陆是今年上半年唯一一个芯片制造设备支出同比继续增加的地区。不过，Clark Tseng 表示，SEMI 预计未来两年中国建设新工厂的总支出将“正常化”。

此前有机构表示，根据中国海关总署本周发布的最新贸易数据，今年 1~7 月中国企业进口了价值近 260 亿美元（约合 1855 亿元人民币）的芯片制造设备，这一数字超过了 2021 年同期创下的最高纪录（238 亿美元）。（资料来源：集微网）

4) 市场需求与技术迭代双驱动，先进封装设备迎高速增长

得益于高性能计算芯片以及消费电子产品需求的快速增强，全球主要半导体制造厂商不断扩大先进封装产能，带动先进封装设备市场也进入高速增长阶段。集邦咨询数据显示，先进封装设备销售额预计在 2024 年增长 10% 以上，2025 年有望超过 20%。

与此同时，随着先进封装技术的发展，相关设备的创新迭代也在加速，创造出更多新的市场机遇。

大厂热情不减，全球迎先进封装扩产潮

最新消息显示，台积电收购群创南科厂，将投资建设 CoWoS 产能，预计明年 4 月开始交机、最快下半年即可投产。此外，台积电还在中国台湾地区的竹南、台中、嘉义等台增建先进封装产能。美光虽在与台积电竞购群创南科厂中失利，但扩增先进封装产能的计划不变，近日又有消息传出将购买友达的两座厂房，交易预计年底完成，明年下半年开始投产。前不久，SK 海力士也与美国商务部签署初步备忘录，将在美国印第安纳州投资一座先进封装厂，并有望获得最高 4.5 亿美元的直接补助和最高 5 亿美元的贷款。今年 4 月，SK 海力士便曾宣布将投资 38.7 亿美元在印第安纳州建设先进封装厂。此外，英特尔在美国新墨西哥州、马来西亚居林和槟城，三星在韩国，日月光在中国台湾地区均有新增先进封装产能的计划传出。

中国大陆对先进封装项目的投建也是热情不减，包括华天科技先进封测项目、通富微电先进封装项目、长电微电子晶圆级微系统集成高端制造项目、松山湖佰维存储晶圆级封测项目等。根据市场研究机构 Yole Group 预测，先进封装在整体封装市场中的比例将于 2025 年超过非先进封装、达到 51.03%，2023-2029 年先进封装市场的复合年增长率将达到 11%，市场规模将扩大至 695 亿美元。

设备迭代加速：更高精度、效率和可靠性

随着先进封装技术的发展，相关设备也在不断演进。先进封装设备在精度、速度、功能复杂性、材料适应性以及自动化程度等方面均优于传统封装设备。以 TSV 技术为例，TSV 是一种在硅基板上垂直穿透通孔，实现芯片间三维互联的工艺技术。TSV 工艺设备涉及多个关键步骤，包括通孔刻蚀、绝缘层/阻挡层/种子层沉积、通孔内导电物质填充、晶圆减薄以及晶圆键合等，其中涉及深孔刻蚀设备，PVD、CVD 设备，电镀设备，晶圆减薄设备，晶圆键合设备等。（资料来源：集微网）

5) 高通推出新款 AI PC 芯片，叫阵英特尔与 AMD

高通 (QCOM-US) 周三(4 日)在 2024 年柏林消费性电子展 (IFA 2024) 推出全新的 8 核 Snapdragon X Plus 平台，扩展其 Snapdragon X 系列产品组合，不仅进一步巩固其在轻薄型个人电脑(PC)市场中的领先地位，还带来突破性的人工智能(AI)驱动体验，加大挑战英特尔 (INTC-US) 和超微 (AMD-US) 地位的力道。

据了解，Snapdragon X Plus 平台专为 700 至 900 美元价位区间的 Copilot+ PC 设计，旨在为广大消费者和企业使用者带来卓越的效能、长时间的电池续航力，以及突破性的 AI 驱动体验。

该平台以 8 核心的高通 Oryon CPU 为基础，具备迅速的反应速度和效率，与同类产品相比，其 CPU 效能提升高达 61%，而功耗则比竞争对手低 179\$。这使得搭载该平

台的 PC 能够在维持高效能的同时，提供长达数日的电池续航力，满足现代使用者对移动装置长时间使用的需求。不只如此，Snapdragon X Plus 还配备强大的 GPU，可支援多达三台外部显示器，提供优异的图像处理能力和沉浸式视觉体验，为用户带来全方位的高品质电脑使用体验。

值得注意的是，高通的 Snapdragon X 系列是基于英国芯片设计公司安谋 (ARM-US) 的架构构建，让处理器以良好的能效运行复杂的应用程式，这是延长设备电池寿命的关键。（资料来源：集微网）

6) SK 海力士 HBM3E 量产时间提前至 9 月底

SK 海力士总裁 Kim Joo-sun 于 9 月 4 日出席“Semicon Taiwan 2024”并发表“面向 AI 时代的 HBM（高带宽存储器）和先进封装技术”主题演讲，宣布 SK 海力士将于 9 月开始量产其 12 层第五代高带宽存储器 HBM3E 产品，时间点早于原先规划的第四季度。

Kim Joo-sun 表示：“8 层 HBM3E 产品自今年年初开始供货，是业界首款产品，12 层产品也将于本月底开始量产。”这一进展有望显著提高数据传输速度和效率，这对于 HPC（高性能计算）和人工智能（AI）应用至关重要。

此外，SK 海力士计划将于 2025 年下半年推出 12 层 HBM4，2026 年推出 16 层 HBM4。至于 16 层 HBM4 的封装技术，公司将决定采用原本的 MR-MUF，或改用 Hybrid Bonding（混合键合）以降低厚度。

除了 HBM3E 的进步之外，SK 海力士还计划推出基于最新四级单元（QLC）技术的业界容量最高的企业级固态硬盘（eSSD）。与传统硬盘（HDD）相比，这款新型 eSSD 将在容量、速度和容量等性能方面有所提升。“我们计划推出一款 120TB 型号，这将极大地提高未来的能效和空间优化。” Kim Joo-sun 透露。（资料来源：集微网）

7) 三星与台积电达成合作 开发无缓冲 HBM4 AI 芯片

据报道，三星电子正与台积电合作开发下一代高带宽存储器 HBM4 人工智能 (AI) 芯片，以加强其在快速增长的 AI 芯片市场的地位。在 Semicon Taiwan 2024 论坛上，台积电生态系统和联盟管理负责人 Dan Kochpatcharin 表示，两家公司正在开发无缓冲的 HBM4 芯片。

分析人士表示，如果三星和台积电合作开发无缓冲 HBM4 芯片，这将是双方在 AI 芯片领域的首次合作。在代工或合同芯片制造领域，三星是第二大厂商，与规模更大的竞争对手台积电激烈竞争。

行业官员表示，无缓冲 HBM4 的能效比现有型号高 40%，延迟比现有型号低 10%。

三星将于 2025 年量产 HBM4。消息人士称，三星与台积电的合作将从尖端的第六代 HBM4 芯片开始，这家韩国公司计划于明年下半年开始量产该芯片。虽然三星能够

提供全面的 HBM4 服务，包括内存生产、代工和先进封装，但它希望利用台积电的技术来获得更多客户。

市场研究公司 TrendForce 的数据显示，三星占有 HBM 市场 35% 的份额。为巩固 HBM 领导地位，未从事代工业务的 SK 海力士于今年 4 月宣布与台积电合作生产 HBM4 芯片，计划在 2026 年量产。（资料来源：集微网）

8) Q2 全球 GPU 出货量环比增长 1.8%，英伟达份额升至 20%

Jon Peddie Research (JPR) 发布了最新的季度 GPU 出货量报告，展示了 GPU 市场最新趋势。根据该报告，从 2024 年第一季度到 2024 年第二季度，季度 GPU 出货量环比增长 1.8%。GPU 总出货量同比增长 16%。

JPR 数据显示，2024 年第二季度，基于 PC 的 GPU 总出货量达到 7000 万台，通常来说，二季度 GPU 出货量与第一季度相比普遍减少。2024 年第二季度 GPU 出货量环比增长 1.8% 是不寻常的，因为从第一季度到第二季度的 10 年平均水平为下滑 7%。报告称，这不是由于任何季节性因素造成的。

数据显示，第二季度，包括所有类型的 GPU 在内的总出货量同比增长 16%，其中台式机显卡增长 21%，笔记本电脑显卡增长 13%。

AMD 在第二季度在整个 GPU 市场份额增加 0.2 个百分点，而英伟达则以 2 个百分点的增幅领先，占整个市场的比重从 18% 增加到 20%。另一方面，英特尔的市场份额下降 2.1 个百分点，从 66% 降至 64%。

出货量方面，AMD 增长 3%，英特尔下降 1.4%，英伟达增长 10%。英伟达在其收益报告中确实报告了创纪录的游戏收入，其 GeForce RTX 40 系列 GPU 需求强劲。

PC CPU 市场也发生明显变化，环比下降 4.6%，总体同比增长 10.7%。2024~2026 年预测表明 GPU 的复合年增长率为 4.2%，预计出货量达到 33 亿台。预计未来五年 dGPU 在 PC 中的渗透率将达到 23%。

尽管目前市场动荡不安，但 JPR 报告称，半导体行业预测第三季度出货量将增长 7.6%，远高于去年下滑 7.9% 的水平。然而，根据 10 年平均值，第二季度至第三季度的出货量增长率将仅为 0.9%。（资料来源：集微网）

9) 三星、SK 海力士上半年中国区营收倍增

据报导，今年上半年（2024 年 1-6 月）三星电子、SK 海力士 (SK Hynix) 于中国市场的营收倍增。韩国半导体大厂三星电子、SK 海力士今年上半年（1-6 月）于中国市场的营收（销售额）呈现倍增。最近 3 年来，因半导体需求低迷，导致三星、SK 海力士中国销售减少。不过今年来转为增加，主要因为中国为了研发 AI 开始囤积存储产品，狂买韩国半导体，加上中国智能手机需求复苏。据悉中国企业开始采购 AI 所需的存储产品「HBM」。

报导指出，在分析三星最近公布的半年报得知，今年上半年主要区域营收中，中国市场达 32 兆 3,452 亿韩元，较去年同期（17 兆 8,080 亿韩元）暴增近 1 倍。三星营收中，除了半导体外，也包含了智能手机、家电等产品，不过中国市场有别于欧美市场，其营收中高达 90% 以上为半导体，也让中国市场占三星整体营收比重从 21.74% 扩大至 30.81%。

SK 海力士上半年中国市场营收达 8 兆 6,061 亿韩元，较去年同期（3 兆 8,821 亿韩元）飙增逾 1 倍。主因中国智能手机厂商大量采购存储产品，加上 DRAM、NAND Flash 价格上涨也推升业绩。（资料来源：集微网）

10) 全球存储市场上半年规模同比增长 97.7%

专业存储市场调研机构 CFM 闪存市场近日发布的数据显示，2024 年二季度全球 NANDFlash（非易失性存储器）市场规模环比增长 18.6% 至 180.0 亿美元，DRAM（易失性存储器）市场规模环比增长 24.9% 至 234.2 亿美元。全球存储市场规模二季度环比增长 22.1% 至 414.2 亿美元，同比大增 108.7%。2024 年上半年，全球存储市场规模达 753.3 亿美元，同比增长 97.7%。

驱动存储市场复苏的原因，既包括此前两年市场过度下跌后的修复与回归，也有存储原厂主动减产及削减资本开支以推动市场供需恢复平衡的努力。更关键的是，AI（人工智能）算力基建需求飙升给存储行业带来新的增长动能。

但最近一段时间，强劲复苏的存储市场也开始出现变数。半导体行业知名研究机构 TrendForce 集邦咨询近日发布研报称，2024 年第二季度存储模组厂在消费类 NANDFlash 零售渠道的出货量已大幅年减 40%，反映出全球消费性存储器市场正面临严峻挑战，下半年的需求不会大幅回温。

消费型存储器市场之所以面临严峻挑战，是因为占存储芯片需求大头的 PC（个人计算机）和手机的增速远没有达到市场预期。华南一家存储厂商的市场经理称：“现在，对后市只有谨慎，不乐观也不悲观，AI 暂时不一定做得了存储的救世主。”

此外，根据 CFM 闪存市场统计数据，NANDFlash 和 DRAM 现货价格指数自今年 5 月份触及阶段高点后便开始一路下跌，目前已经回到了 2023 年末的水平。TrendForce 集邦咨询亦在近日发表的研报中表示，以消费产品为主的存储器现货价格开始走弱，第二季价格较第一季下跌超过 30%。（资料来源：集微网）

2.2 消费电子板块

1) 我国 AR 设备上半年销量同比增长近五成

第三方机构洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国 VR/AR 设备零售市场月度追踪（China VR/AR Devices Retail Market Monthly Tracker）》报告显示，2024 年上

半年，我国消费级 XR 设备（包括 AR 和 VR）的全渠道销量达到 26.1 万台。AR 设备全渠道销量达到 11.0 万台，同比增长 49%，成为整体 XR 市场增量的主要来源。

具体来看，上半年，VR 设备的全渠道销量为 15.1 万台，同比下降 41%，这显示出 VR 市场在经历一段时间的快速增长后，正面临去库存和消费者兴趣减退的双重压力。

在线上市场方面，XR 设备的表现也略显疲态。数据显示，2024 年上半年，XR 设备在线上公开零售市场（不含抖音、快手等内容电商平台）的销量占全渠道的 43.4%，销量为 11.5 万台，同比下降 17.6%；销售额为 3.5 亿元，同比下降 20.5%。值得注意的是，VR 设备在中国整体 XR 线上市场的份额逐渐被 AR 设备超越，上半年 VR 设备的线上销量占比降至 44.5%，而去年同期高达 69.4%。

报告认为，上半年 VR 市场的低迷与多个因素有关。一方面，VR 产品仍处于去库存的出清阶段，新品发布节奏放缓，消费者购买意愿不强；另一方面，被寄予厚望的 Apple Vision Pro 等高端产品的市场表现也未达预期，未能有效提振市场信心。此外，XR 产品在交互方式友好性、佩戴使用舒适性和内容生态丰富性等方面仍面临挑战，限制了市场的进一步扩张。

相比之下，AR 设备市场快速增长。报告显示，目前市场上的主流 AR 眼镜主要分为分体式和一体式两种，其中分体式 AR 眼镜占据市场主导地位，销量占比达到 80.7%。同时，采用 Micro LED 屏幕+光波导方案的 AR 设备也逐渐受到市场青睐，占据了整体市场份额的 13.3%。（资料来源：集微网）

2) 折叠屏手机火热，推动 LTPS 与 LTPO 技术发展

根据 TrendForce 集邦咨询发布的最新显示器背板研究，折叠屏手机市场持续火热，推动了 LTPS（低温多晶硅）和 LTPO（低温多晶氧化物）等中高端背板技术发展。统计表明，二者在 2024 年智能手机市场的渗透率接近 57%；预计到 2025 年，因良率提升和成本有效控制，渗透率有望达到 60%。

研究报告称，LTPS 背板技术如今已非常成熟。LTPS 具有高电子迁移率的特性，能提供较快开关速度和更高分辨率，满足高端手机的显示需求。但高电子迁移率也导致低温多晶硅漏电流较大，无法支持低频动态刷新调节，导致整体功耗较大。

研究显示，目前大部分旗舰手机采用低温多晶氧化物（LTPO）背板技术，而屏幕尺寸更大的折叠手机中，可以通过 LTPO 达到画面分割且刷新率不同的效果，兼顾画面多任务模式和节能效果。LTPO 技术是在 LTPS 的基础上增加氧化物半导体，以优化显示性能，包括改善驱动画面时的漏电流情况，并根据显示内容调整屏幕刷新率。然而，由于 LTPO 的生产过程需要堆叠更多层数，其制程复杂，制造成本也较 LTPS 更高。

研究认为，目前普遍用于智能手机屏幕的氧化物（Oxide）半导体背板技术，主

要采用氧化锌 (ZnO) 或氧化铟镓 (IGZO) 等材料, 这项技术也常用于高端显示器, 像 Apple 的 iPad 和 MacBook 系列等中尺寸产品, 而得益于 Oxide 的漏电流较低, 在透明显示器领域有广泛应用前景。(资料来源: 集微网)

3) 苹果 iPhone 明年起全部采用 OLED 屏幕, 夏普和 JDI 被淘汰

据报道, 从 2025 年起, 苹果公司销售的所有 iPhone 型号都将使用 OLED 屏幕, 包括低端的 iPhone SE 机型。这意味着, 夏普和 JDI 两家面板供应商将被排除在苹果的手机业务之外。

大约十年前, JDI 和夏普合计占到了 iPhone 屏幕份额的约 70%。但最近, 这两家供应商仅为 iPhone SE 提供 LCD 屏幕, 因为苹果已将高端型号 iPhone 的屏幕转向 OLED, 该市场由韩国和中国公司主导。

多个消息来源称, 苹果已开始向中国的京东方和韩国的 LG Display 订购即将上市的 iPhone SE 的 OLED 屏幕。这一变化标志着 LCD 屏幕在 iPhone 产品线中的终结。

当前, 三星电子占据了 iPhone OLED 屏幕市场约一半的份额, 而 LG display 约占 30%, 京东方约占 20%。JDI 和夏普目前都没有大规模生产用于智能手机的 OLED 屏幕。对此, 苹果尚未发表评论。

苹果在 2017 年首次亮相的 iPhone X 中首次使用了 OLED 屏幕。此后, 苹果就将其高端 iPhone 型号从 LCD 转向 OLED。2015 年左右, JDI 和夏普每年为 iPhone 交付近 2 亿块 LCD 屏幕, 但到 2023 年, 这一数字已降至约 2000 万块。

市场研究机构 Omdia 称, 今年用于智能手机的 OLED 面板出货量将首次超过 LCD。随着 iPad 和其他产品开始采用 OLED 屏幕, 预计苹果将进一步削减其 LCD 屏幕采购量。(资料来源: 集微网)

4) Q2 全球智能手机 AP 市场排行榜: 紫光展锐出货量大涨 42%

近日, 研究机构 Canalys 发布 2024 年第二季度智能手机处理器 (AP) 市场报告, 其中联发科手机出货量份额 40%, 继续稳居第一; 如果以销售额占比来看, 苹果则排名第一, 市场份额为 39%。

具体来说, 2024 年第二季度, 基于联发科处理器的智能手机出货量同比增长 7% 至 1.153 亿台, 市场份额高达 40%, 排名第一; 销售额增长 5% 至 220 亿美元, 市场份额为 19%, 排名第三。

基于高通处理器的智能手机出货量增长 6% 至 7100 万部, 市场份额为 25%, 排名第二; 销售额下滑 6% 至 310 亿美元, 市场份额 26%, 位居第二。

苹果 2024 年二季度智能手机市场出货量增长 6% 至 4600 万部, A17 Pro 等手机处理器出货量份额为 16%, 排名第三; 销售额增长 9% 至 470 亿美元, 占据整个市场 39% 份额, 位居第一。

基于紫光展锐处理器的智能手机出货量同比大涨 42%至 2500 万部，出货量份额 9%，排名第四；销售额同比增长 31%至 30 亿美元，市场份额排名第六。

得益于其支持 AI 的旗舰产品 Exynos 2400，三星 Exynos 系列智能手机出货量增长 9%至 1700 万部，排名第五；销售额同比增长 71%至 80 亿美元，排名第四。

基于海思处理器的智能手机出货量为 800 万部，市场份额排名第六；销售额约 60 亿美元，市场份额排名第五。（资料来源：集微网）

5) 全球高端智能手机 Q2 市场排名出炉

据 Canalys 披露数据显示，高端手机市场需求仍然保持韧性，二季度全球 600 美元以上出货量前五厂商皆保持同比增长。苹果通过其 Apple Intelligence 服务的推出重燃市场关注，并扭转一季度的下跌，在二季度同比增长 5%，以 62%的份额稳居高端市场首位。

三星 Galaxy S24 需求延续，出货同比增长 35%，以 22%的市场份额位居第二。小米凭借其 14 系列的持续需求，同比增长 71%，出货量位居第四。vivo 在其本土市场实现了强势增长，并凭借 X 系列折叠旗舰在高端领域进一步扩大市场份额，位列第五。

在中国大陆地区，苹果以 52%的市场份额位于第一，小米、vivo、荣耀分别位于第三至第五位。

在亚太（不含大中华）地区，苹果出货量同比增长 23%，以 60%的市场份额位于第一。紧随其后的则是三星，其出货量同比增长 69%，市场份额为 34%。

谷歌、OPPO、小米的市场份额分别为 2%、1%、1%，分别位于第三至第五位，其中谷歌出货量同比增长 196%，小米则增长率 564%。

在美洲（北美+拉美）地区，苹果、三星分别为以 72%、25%的市场份额位于前两位。联想以 1%的市场份额位于第三位，不过其出货量同比下降 53%；紧随其后的则是谷歌和 vivo，其中 vivo 出货量同比增长 409%。

在欧洲/中东/非洲地区，苹果以 61%的市场份额位于第一，而三星的出货量同比增长 45%，以 32%的市场份额位于第二，小米、谷歌、联想位于第三至第五，其中小米出货量同比增长 100%。（资料来源：集微网）

6) TrendForce: iPhone 16 Pro 两款机型都将配备 256GB 基本存储空间

根据 TrendForce 的一份最新报告，苹果预计将为 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 提供至少 256GB 的存储空间，首次取消了较小 Pro 机型 128GB 的起始选项。目前，苹果 6.1 英寸 iPhone 15 Pro 的起价为 999 美元，最低配备 128GB 存储空间，而 6.7 英寸 iPhone 15 Pro Max 的起价为 1199 美元，最低配备 256GB 存储空间。

在 iPhone 15 机型发布之前，有传言称 iPhone 15 Pro Max 的起价可能为 1199 美元，而不是 iPhone 14 Pro Max 的 1099 美元起价。

事实证明这种说法是准确的，但这只是因为苹果取消了价格较低的 128GB 存储容量。iPhone 15 Pro Max 现在的起售价为 256GB，而 1199 美元的价格与苹果对 256GB iPhone 14 Pro Max 的售价相同。展望即将推出的 iPhone 16 系列，TrendForce 认为苹果将对 iPhone 16 Pro 机型采取同样的策略。

据传，今年的 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 的显示屏尺寸将增大，分别增至 6.27 英寸和 6.86 英寸。相比之下，iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 分别配备了 6.1 英寸和 6.7 英寸显示屏。新的显示屏尺寸将是 iPhone 有史以来最大的，同时也会增加内部组件和部件的物理空间。

苹果公司将于下周一（9 月 9 日）在发布会上发布新款 iPhone 16 系列，其标语为 "It's Glowtime"，据信是指 Apple Intelligence 配备的新 Siri 界面。（资料来源：集微网）

7) 把 AI PC 价格打下来，联想多款基于骁龙 X Plus 8 核笔记本发布

在 IFA 2024 展会上，联想推出了三款 AI PC，均搭载高通最新的骁龙 X Plus 8 核处理器，提供了与 X Elite 相同的 NPU，推动 AI PC 的普及和价格的亲民化。其中新款 ThinkBook 16 Gen 7 专为中小企业用户设计，拥有 16 英寸的高屏占比显示屏和长达 30 小时的本地视频播放续航能力。

此外，ThinkBook 16 Gen 7 还具备嵌入式安全性和微软 Pluto 的芯片到云技术，为用户带来企业级的加密服务和安全保障。

针对主流消费者，联想还发布了两款 IdeaPad 新机型，分别是 IdeaPad Slim 5x 和 IdeaPad 5x 二合一笔记本。（资料来源：集微网）

2.3 汽车电子板块

1) 乘联会：预计 8 月新能源乘用车批发销量达 105 万辆，特斯拉中国达 8.67 万辆

9 月 2 日，乘联分会发布 8 月新能源乘用车厂商批发销量快讯称，根据月度初步数据综合预估 8 月全国新能源乘用车厂商批发销量 105 万辆，同比增长 32%，环比增长 11%。

其中，比亚迪断崖式领先，8 月销量达 370854 辆；特斯拉中国紧随其后，8 月销量为 86697 辆；吉利第三，销量为 75484 辆，销量超 3 万辆的企业还有：长安汽车（预估 49000 辆）、理想汽车（48122 辆）、奇瑞汽车（43042 辆）、上汽通用五菱（41514 辆）、赛力斯（33572 辆）、零跑汽车（30305 辆）。

销量超 2 万辆的车企有：东风汽车（29976 辆）、长城汽车（24769 辆）、蔚来汽车（20176 辆）。

此外，销量介于 1 万辆-2 万辆之间的车企有：小鹏汽车、上汽大众、一汽红旗、北汽乘用车、小米汽车、哪吒汽车、沃尔沃亚太、极狐汽车。（资料来源：集微网）

2.4 面板板块

1) 机构：9 月起面板厂利用率将跌至 75%~80%

7、8 月面板价格不断下跌，第三季度恐跌回今年电视面板价格起涨点，面板厂 9 月起将扩大减产。IDC 资深分析师陈建助表示，9 月面板厂至少再减 5%~10% 的投片量，十一长假期间中国大陆面板厂有意顺势停产两周，9、10 月大尺寸面板平均产能利用率将下探至 75%~80%。

对于热议的《黑神话：悟空》能否刺激面板需求，陈建助表示，《黑神话：悟空》的确让既有的电脑规格不足，会有换新电脑的需求，面板解析度要求 Full HD 以上，frame rate（画面更新率）要达到 165Hz、甚至是 180Hz 以上。不过今年全球消费降级，高端电竞产品卖不动。目前来看，该游戏刺激出高端电竞产品需求增温，但销售增长可能只有数十万台，对市场实质贡献有限。

10 月份中国大陆迎来十一长假，先前包括华星光电在内的中国大陆面板厂均释出有意停产两周的消息。陈建助表示，以此估计 10 月份面板厂可能扩大减产约 25%，平均产能利用率将下探到 80% 以下。随市场逐步迈入淡季，预期第四季度面板厂的平均产能利用率都将处于 75%~80%。

此外，集邦咨询的研究副总经理范博毓也曾表示，由于时序越近年底，需求将越来越朝向淡季的节奏调整，因此就算面板厂持续运行按需生产调控策略，短时间之内也不容易见到面板价格止稳，目前仍需观察主要面板厂在 10 月假期计划停产两周的想法是否能确切运行，借此机会来寻求面板价格走稳的契机。

液晶显示器（Monitor）面板进入 8 月后，整体需求逐步减弱，部分客户的拉货动能下滑，也影响面板价格。以面板厂来看，目前仍多是希望面板价格能持续维持台面上的稳定，转以台面下折让或其他方式给客户实质的优惠。（资料来源：集微网）

2) 研调：全球 AMOLED 手机面板今年出货估年增 24%，中国厂商明年超韩称霸

研调中心 TrendForce 报告指出，AMOLED 手机面板市场迎来快速增长，2024 年出货量预计突破 8.4 亿片，年增近 25%，与此同时，中国面板厂商崛起，预估 2025 年中国面板厂市占率达 50.2%，有望首次超越韩厂。

AMOLED 技术在智慧型手机市场的渗透率持续攀升，从 2023 年的 51% 上升至 2024

年的 56.9%。分析师预测，此趋势将延续至 2028 年，渗透率有望达到 68%，进一步巩固 AMOLED 作为智慧型手机主流显示技术的地位。

在中国面板厂中，京东方(BOE)表现尤为亮眼，已跃升为该国 AMOLED 手机面板出货龙头。2024 年京东方预计出货量将达 1.3 亿片，不仅与本土品牌紧密合作，更成功通过 iPhone 16 系列新机种验证，展现其与国际一线大厂竞争的实力。

此外，其他中国厂商如维信诺(Visionox)、天马和华星光电(CSOT)也在今年大幅提升出货量，有望创下新高。维信诺受益于华为新机热销，2024 年出货量预计可达 8,000 万片。(资料来源：集微网)

3) 机构：明年中国面板厂商 OLED 市场份额将增至 50.2%，超过韩国

中国显示器公司正在迅速扩大其在智能手机 OLED 市场的主导地位，其中京东方作为苹果 iPhone 系列的主要供应商取得了重大进展。9 月 5 日消息，据业内人士透露，苹果已将中国京东方、三星显示 (Samsung Display) 和 LG 显示 (LG Display) 一起列入 iPhone 16 OLED 面板供应商名单。

京东方于 2020 年底进入苹果供应链，自 iPhone 12 以来一直供应 OLED 面板，预计今年将为 iPhone 16 标准机型供应 OLED 面板。三星显示将为所有四种型号供应 OLED 面板：标准型、Plus、Pro 和 Pro Max，而 LG 显示将为 Pro 和 Pro Max 型号供应面板。

目前，三星显示占据 iPhone OLED 显示器市场 50% 的份额，LG 显示和京东方分别占据 30% 和 20% 的份额。这标志着京东方的快速增长，2021 年京东方的市场份额为 8%。

此外，苹果计划从明年起在所有 iPhone 机型中使用 OLED，其中中低端 iPhone SE 将从 LCD 过渡到 OLED。这预计将进一步增加京东方的 OLED 供应量。有报道最近援引多个消息来源称，苹果已开始向京东方和 LG 显示订购 iPhone SE4 的 OLED 显示屏。

苹果扩大 OLED 智能手机产品线的战略预计将导致全球 OLED 面板供应顺利。市场研究公司 Omdia 预测，智能手机 OLED 显示面板的数量将从去年的 6.1 亿片增加到今年的 8 亿片，增长 31.1%。此外，OLED 在智能手机显示面板总量中的份额预计将从 2023 年的 42.7% 跃升至 2024 年的 55.8%，增长 13.1 个百分点。

报道称，除京东方作为苹果生态系统的一部分正在扩大其全球主导地位外，维信诺和 TCL 华星光电等其他中国公司正在利用价格竞争力和庞大的国内市场迅速扩大其在 OLED 市场的版图。维信诺预计今年 OLED 面板出货量将达到 8000 万片，天马和 TCL 华星光电今年也有可能通过增加智能手机面板出货量来超越之前的记录。

据市场研究公司 CINNO Research 统计，今年上半年，OLED 智能手机面板全球出货量份额为京东方 16.1%、维信诺 11.3%、华星光电 9.7%、天马 9%。中国 OLED 市场的快速增长预计将很快超过韩国。TrendForce 预测，明年 OLED 智能手机面板出货量

将较今年增长3.2%，达到8.7亿片。还预测中国面板厂商的市场份额将从今年的47.9%增至明年的50.2%，超过韩国企业的OLED出货份额。（资料来源：集微网）

三、 公司动态跟踪

图表 9：过去一周股东增减持更新

证券代码	证券简称	公告日期	方向	股东名称	股东身份	拟变动数量上限	拟变动数量上限占总股本比(%)
688150.SH	莱特光电	2024-09-04	减持	北京君联成业股权投资合伙企业(有限合伙),北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	8,048,750.00	2.00
300566.SZ	激智科技	2024-09-04	减持	俞根伟	持股5%以上股东	2,637,400.00	1.01
300709.SZ	精研科技	2024-09-03	减持	常州创研投资咨询有限公司	控股股东,实际控制人的一致行动人	1,860,766.00	1.00
688210.SH	统联精密	2024-09-03	减持	天津清启陆石创业投资中心(有限合伙)	5%以下股东	812,481.00	0.51
688210.SH	统联精密	2024-09-03	减持	天津清研陆石投资管理有限公司-天津陆石昱航股权投资中心(有限合伙)	5%以下股东	487,489.00	0.31
688416.SH	恒烁股份	2024-09-06	减持	合肥中安海创创业投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	481,129.00	0.58
688416.SH	恒烁股份	2024-09-06	减持	合肥市天使投资基金有限公司	5%以下股东	211,277.00	0.26
300088.SZ	长信科技	2024-09-05	减持	新疆润丰股权投资企业(有限合伙)	持股5%以上股东	9,630,000.00	0.40
300433.SZ	蓝思科技	2024-09-04	减持	周新益	监事	482,075.00	0.01
603893.SH	瑞芯微	2024-09-03	减持	黄旭	董事,监事,高级管理人员	4,180,000.00	1.00
603893.SH	瑞芯微	2024-09-07	减持	黄旭	董事,监事,高级管理人员	4,180,000.00	1.00
300812.SZ	易天股份	2024-09-05	减持	柴明华	董事	780,000.00	0.56
300812.SZ	易天股份	2024-09-05	减持	高军鹏	董事长,总经理	650,000.00	0.46
300812.SZ	易天股份	2024-09-05	减持	胡靖林	董事	400,000.00	0.29
300812.SZ	易天股份	2024-09-05	减持	刘权	财务总监	25,000.00	0.02
605258.SH	协和电子	2024-09-03	减持	常州东禾投资管理中心(有限合伙)	5%以下股东	440,000.00	0.50
605258.SH	协和电子	2024-09-03	减持	常州协诚投资管理中心(有限合伙)	5%以下股东	440,000.00	0.50
605588.SH	冠石科技	2024-09-05	减持	门芳芳	董事,监事,高级管理人员	354,166.00	0.48
605588.SH	冠石科技	2024-09-05	减持	王顺利	董事,监事,高级管理人员	125,000.00	0.17

数据来源：Wind，华福证券研究所

图表 10：过去一周股权激励一览

代码	名称	公告日期	方案进度	激励方式	激励总数 (万)	激励总数占当时 总股本比例 (%)	期权初 始行权 价格
长信科技	2024-09-07	2024-09-07	董事会预案	上市公司提取激励基金买入流通股	3,376.00	1.3752	2.97
澜起科技	2024-09-03	2024-09-03	董事会预案	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	454.10	0.3974	26.60
002655.SZ	共达电声	2024-09-03	实施	上市公司定向发行股票	1,800.00	5.0000	10.60
688233.SH	神工股份	2024-09-03	实施	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	95.04	0.5581	13.82
688381.SH	帝奥微	2024-09-03	股东大会通过	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	726.50	2.8807	9.58
001309.SZ	德明利	2024-09-05	实施	上市公司定向发行股票	142.65	0.9666	45.03

数据来源：Wind，华福证券研究所

四、 风险提示

技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险；行业景气不及预期。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

一般声明

华福证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，该等公开资料的准确性及完整性由其发布者负责，本公司及其研究人员对该等信息不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，之后可能会随情况的变化而调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司仅承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告以供投资者参考，但不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。

本报告版权归“华福证券有限责任公司”所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	评级	评级说明
公司评级	买入	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在 20%以上
	持有	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于 10%与 20%之间
	中性	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与 10%之间
	回避	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-20%与-10%之间
	卖出	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在-20%以下
行业评级	强于大市	未来 6 个月内，行业整体回报高于市场基准指数 5%以上
	跟随大市	未来 6 个月内，行业整体回报介于市场基准指数-5%与 5%之间
	弱于大市	未来 6 个月内，行业整体回报低于市场基准指数-5%以下

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。

联系方式

华福证券研究所 上海

公司地址：上海市浦东新区浦明路 1436 号陆家嘴滨江中心 MT 座 20 层

邮编：200120

邮箱：hfyjs@hfzq.com.cn